

# 2016-2022年中国半导体封装用键合铜丝市场分析与投资前景研究报告

## 报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

[www.bosidata.com](http://www.bosidata.com)

## 报告报价

《2016-2022年中国半导体封装用键合铜丝市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/jinshu1510/I09165YWHN.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7000元 纸介+电子7200元

【出版日期】2015-10-22

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

# 说明、目录、图表目录

## 报告说明:

博思数据发布的《2016-2022年中国半导体封装用键合铜丝市场分析与投资前景研究报告》共七章。报告介绍了半导体封装用键合铜丝行业相关概述、中国半导体封装用键合铜丝产业运行环境、分析了中国半导体封装用键合铜丝行业的现状、中国半导体封装用键合铜丝行业竞争格局、对中国半导体封装用键合铜丝行业做了重点企业经营状况分析及中国半导体封装用键合铜丝产业发展前景与投资预测。您若想对半导体封装用键合铜丝产业有个系统的了解或者想投资半导体封装用键合铜丝行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

## 报告目录：

### 第一章概述

#### 1.1键合内引线材料

##### 1.1.1半导体的引线键合技术发展

##### 1.1.2引线键合技术(WB)

##### 1.1.3载带自动键合技术(TAB)

##### 1.1.4倒装焊技术(FC)

#### 1.2键合丝及作用

##### 1.2.1键合丝定义及作用

##### 1.2.2键合丝在IC封装中的作用

#### 1.3键合丝的主要品种

#### 1.4键合金丝的主要品种分类

##### 1.4.1按用途及性能划分

##### 1.4.2按照键合要求的弧度高低划分

##### 1.4.3按照键合不同封装形式划分

##### 1.4.4按照键合丝应用的不同弧长度划分

### 第二章键合铜丝行业、市场的情况

#### 2.1世界半导体封装用键合丝行业发展概述

#### 2.2封装用键合丝行业的发展特点

#### 2.3世界键合丝的市场情况

- 2.3.1键合铜丝市场发展历程
- 2.3.2企业制造技术的发展推动了键合铜丝市场扩大及格局的改变
- 2.3.3当前世界及我国键合丝行业面临的问题
  - 2.3.3.1原材料成本的提高
  - 2.3.3.2新品研发的加强
  - 2.3.3.3知识产权的问题越发突出
  - 2.3.3.4国内市场价格竞争更趋恶化
- 2.3.4世界键合铜丝的市场规模
- 2.3.5世界键合铜丝的市场格局
- 2.4我国键合铜丝的市场情况
  - 2.4.1我国整体键合丝市场需求量情况
  - 2.4.2我国键合铜丝市场需求量情况

### 第三章键合铜丝的性能与国外技术发展

- 3.1半导体封装工程对引线键合材料——键合丝的性能要求
  - 3.1.1引线键合在半导体封装制造中的应用
  - 3.1.2对半导体封装工程对引线键合材料——键合丝的性能要求
  - 3.1.3对键合铜丝的主要特性要求
    - 3.1.3.1对键合铜丝的物性要求
    - 3.1.3.2对键合铜丝的表面性能要求
    - 3.1.3.3对键合铜丝的线径要求
- 3.2键合丝的主要采用的标准情况
  - 3.2.1国内外半导体键合用键合丝的主要标准
  - 3.2.2我国半导体键合用铜丝标准的编制情况
- 3.3键合铜丝的特性
  - 3.3.1键合铜丝与其它键合丝主要性能对比
  - 3.3.2键合铜丝的成本优势
  - 3.3.3键合铜丝的性能优势
- 3.4国外主要企业的键合铜丝产品品种及性能
  - 3.4.1国外键合铜丝产品发展概述
  - 3.4.2田中贵金属公司的四种产品
  - 3.4.3新日铁公司的覆Pd键合铜丝

3.4.4贺利氏公司的三种键合铜丝产品

3.4.5MEK电子公司的三种键合铜丝产品

#### 第四章键合铜丝的制造工艺过程及产品知识产权情况

4.1键合铜丝的制造工艺技术

4.1.1键合铜丝的制造工艺流程简述

4.1.2具体工艺的环节

4.1.2.1坯料铸造

4.1.2.2成丝加工

4.1.2.3热处理

4.1.2.4复绕（卷线）

4.2键合铜丝制备过程及影响因素

4.3键合铜丝的组织与微结构

4.4键合铜丝知识产权情况

4.4.1世界及我国键合铜丝专利情况

4.4.2新日铁公司实施专利战略的情况

#### 第五章世界键合铜丝的主要生产企业现况

5.1世界键合金丝的主要生产厂家概述

5.2世界键合铜丝的主要生产厂家及其产品情况

5.2.1田中贵金属株式会社

5.2.1.1企业情况

5.2.1.2键合铜丝产品生产情况

……

5.2.5贺利氏集团

5.2.5.1企业情况

5.2.5.2键合铜丝产品生产情况

#### 第六章我国国内键合铜丝的主要生产企业及其产品情况

6.1概述

6.1.1国内键合丝行业总况

6.1.2国内键合丝生产及其企业分布情况

6.1.3国内键合铜丝行业的生产情况

6.2国内键合铜丝的主要生产厂家及其产品情况

6.2.1贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司

&hellip;&hellip;

6.2.8烟台招金励福贵金属股份有限公司

6.2.9河南优克电子材料有限公司

6.3国内其它新建、在建的键合铜丝生产厂家情况

6.3.1广州佳博金丝科技有限公司

&hellip;&hellip;

第七章键合铜丝应用市场的现状与发展

7.1世界半导体封测产业概况及市场

7.2我国半导体封测产业发展及现况

7.2.1国内IC封装测试业生产现况

7.2.5我国国内分立器件生产企业情况

图表目录略&hellip;&hellip;

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/jinshu1510/I09165YWHN.html>